

～TOKYO PACK 2008 に出展しました～



10月7日～11日に東京ビッグサイトにて開催された東京パック 2008に出展しました。
おかげさまをもちまして、盛況のうちに終えることができました。
ご来場いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。

*****<当社展示テーマ>*****

1. 環境貢献（バイオマス素材）

- ・ Biomax TPS
- ・ 押出ラミネート用バイオマスレジ（開発品）

2. 開発品

- ・ ロック&ピールシーラント
- ・ 強接着樹脂ハイミラン/ニユクレル

3. ハイミラン

- ・ 包材のトータルコストダウン
- ・ 高透明射出成形材料
- ・ スキンパック
- ・ シュリンクフィルム

4. エンティラ

- ・ 高分子型帯電防止剤
- ・ 高周波シール性改良剤

5. ニユクレル

- ・ 環境対応ニユクレル

6. その他

- ・ DuPont Packaging Awards
